

## 半導体洗浄装置の主要3分野で世界トップシェアを獲得

大日本スクリーン製造株式会社は、当社が手掛ける半導体洗浄装置の主要3分野すべてにおいて、2009年における世界トップシェアを獲得し、業界首位の座を2007年から3年連続で堅持しました。枚葉式スプレー洗浄装置<sup>※1</sup>で69.7%、バッチ式洗浄装置<sup>※2</sup>で81.3%、スピンスクラバー<sup>※3</sup>で85.2%となるなど、すべての装置分野で前年のシェアを上回る結果となりました。

2008年秋以降の世界的な景気後退の中、後半にやや回復基調となった2009年の半導体業界において、当社では台湾への出荷が堅調に推移。枚葉式スプレー洗浄装置では前年を9.4ポイント上回る69.7%のシェア(前年60.3%)を獲得しました。また、バッチ式洗浄装置では81.3%(前年57.4%)、スピンスクラバーにおいても85.2%(前年80.1%)という圧倒的な世界シェアを獲得。前年に引き続き、当社の半導体洗浄装置の地位を堅持する結果となりました。

当社は今後も、世界トップシェアに裏付けられた高い製品競争力とサービス体制を一層強化し、顧客ニーズに応える多彩な洗浄装置を提供することにより、半導体業界の技術革新に貢献するとともに、顧客満足度の一層の向上を図っていきます。

※1 枚葉式スプレー洗浄装置

薬液をスプレーして、ウエハーを1枚ずつ洗浄する装置。処理量がバッチ式より少ない(当社装置では1時間当たり300枚)が、洗浄能力が高い。

※2 バッチ式洗浄装置

複数枚のウエハーを一度に薬液などに浸して洗浄する装置。処理能力が高く(当社装置では1時間当たり650枚)、大量生産に向く。

※3 スピンスクラバー

純水だけで洗浄できる工程などで使用される装置。ウエハーを軟らかいブラシと純水で物理洗浄する。

\* 出典：ガートナー「Market Share: Semiconductor Etch and Clean Process Equipment, Worldwide, 2009」  
Authors: By Dean Freeman, Takashi Ogawa, Mark Stromberg, Klaus Rinnen and Barbara Van, 19 April 2010  
(Revenue from Shipments of Single Wafer Processors, Auto Wet Stations and Scrubbers, Worldwide)